

行业资讯

行业动态

会员动态

协会动态

【会员】格科微12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目BSI产线投产成功!

发布者: 郝立超 发布日期: 2022年09月12日

2022年8月31日, 格科微有限公司募投项目“12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目” BSI产线投产成功! 首个晶圆工程批良率超过95%, 标志着BSI产线顺利进入风险量产, 即将步入大规模量产阶段。公司高管和员工代表出席庆祝仪式, 共同见证格科微这一里程碑式的历史性时刻。



格科半导体首批12英寸晶圆BSI制程的顺利出厂并完成测试, 标志着格科微募投项目一期工程初步取得成功。



12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目的顺利投产, 将大大提升格科微的高端产品研发速度及产能保障力度。该项目预计建设期为5年, 总投资为155亿元。

格科微董事长赵立新表示:“近年来CIS产品的设计和制造技术突飞猛进, 为了追求卓越的图像性能, 很多关键工艺步骤与逻辑电路制造工艺越来越不兼容。格科微通过“自建产线、量产研发兼顾”的方式保障了高端CIS特殊工艺的研发速度, 实现对CIS 特殊工艺关键生产步骤的自主可控, 并进一步夯实了12英寸BSI 晶圆的本土供应链, 巩固并提升公司的市场地位和综合竞争力。伴随着项目的顺利投产, 格科微将启动5000万~6400万像素的系列高端主摄产品的工程批研发投产, 后续将持续推出一系列有创新力和竞争力的高端产品, 持续为行业、客户及股东创造价值。”

信息来源: 格科微